



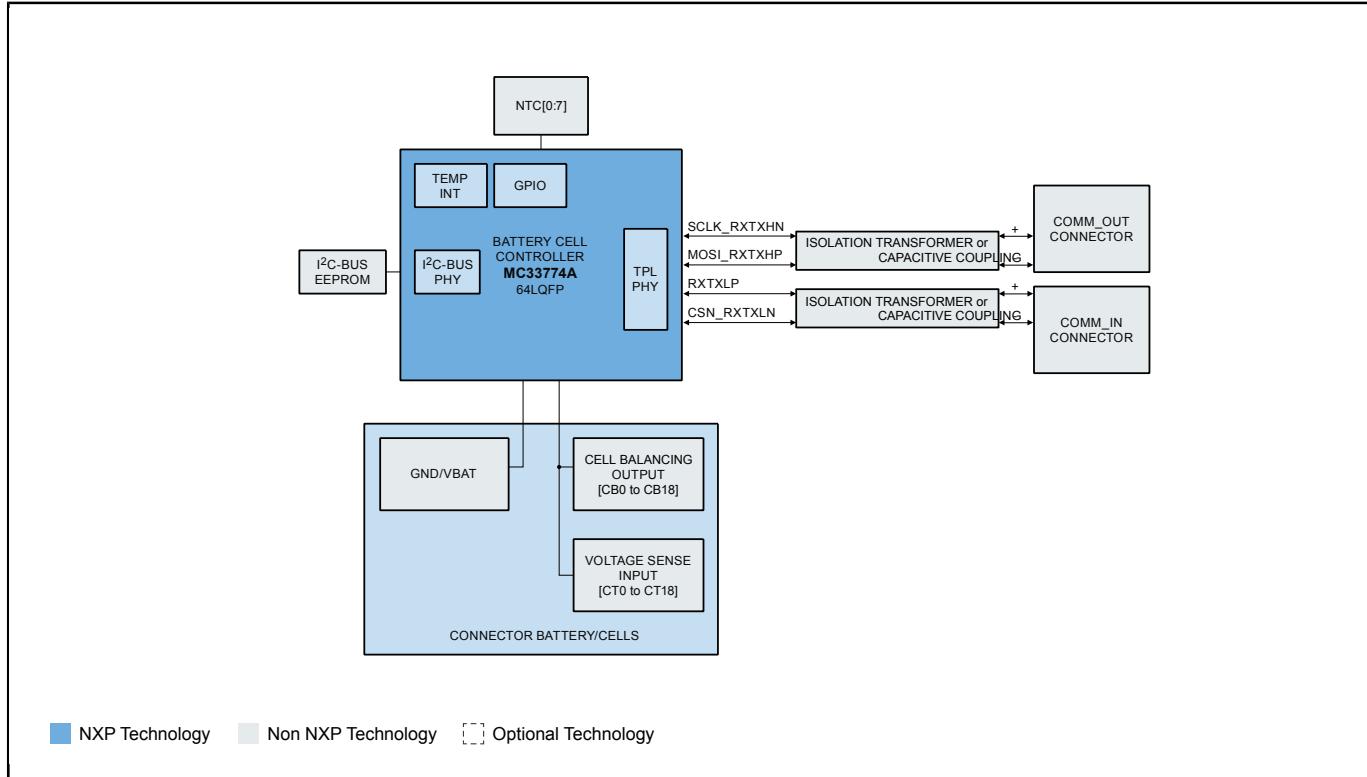
# 絶縁デイジー・チェーン通信を使用する **MC33774A**向け評価ボード

## RD33774ADSTEVB

Last Updated: Sep 12, 2025

RD33774ADSTEVBは、エレクトリカル・トランスポート・プロトコル・リンク (ETPL) 通信を使用する分散型セル・モニタリング・ユニット (CMU) のリファレンス・デザインです。高電圧バッテリー・マネジメント・システム (HVBMS) のハードウェアとソフトウェアの迅速なプロトタイプ作成に最適です。このボードは、デイジー・チェーン構成の1個のMC33774Aアナログ・フロント・エンド (AFE) を搭載しています。

## 絶縁ETPLデイジー・チェーン通信を使用するMC33774A向け評価ボード Block Diagram



View additional information for [絶縁デイジー・チェーン通信を使用するMC33774A向け評価ボード](#).

**Note:** The information on this document is subject to change without notice.

---

[www.nxp.com](http://www.nxp.com)

NXP and the NXP logo are trademarks of NXP B.V. All other product or service names are the property of their respective owners. The related technology may be protected by any or all of patents, copyrights, designs and trade secrets. All rights reserved. © 2025 NXP B.V.